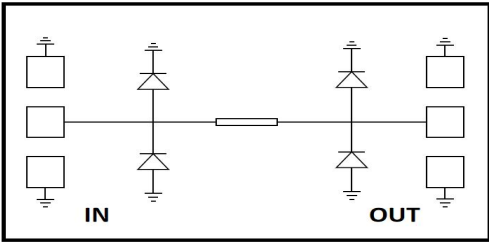


GaAs 限幅器芯片 10-18GHz

主要性能

- ◎ 工作频段：10~18 GHz
- ◎ 插入损耗：0.39 dB
- ◎ 最大输入功率：19.5W
(pulsed.PW=2ms.DC=20%)@12GHz
- ◎ 芯片尺寸：1.468 x 0.927 x 0.1mm

功能框图



产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性,非常适用于微波混合集成电路及 TR 组件模块等领域。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。可应用于以下范围:

- ◎ 无线通信设备
- ◎ 军事和航天
- ◎ 测试仪器
- ◎ 雷达和电子对抗

极限参数

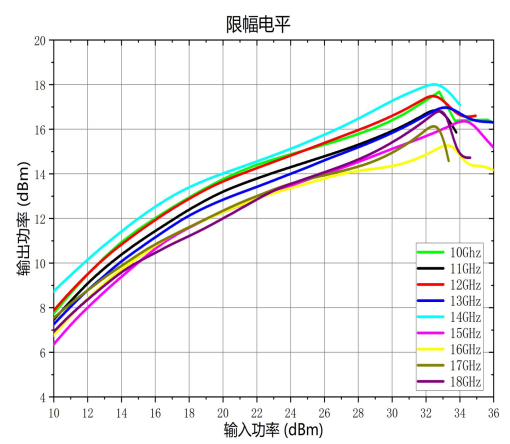
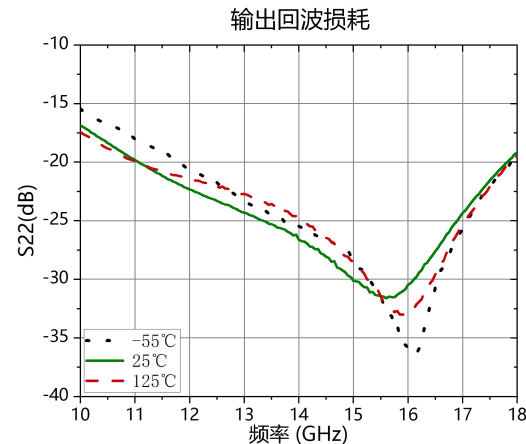
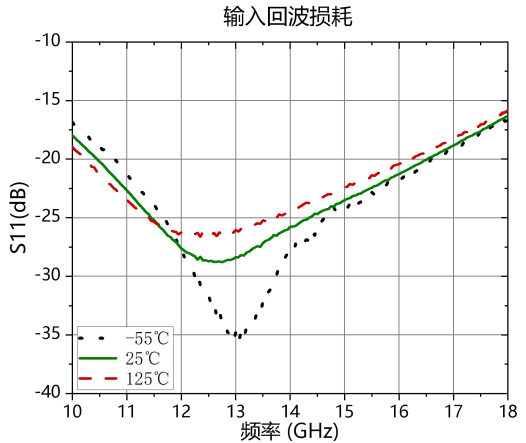
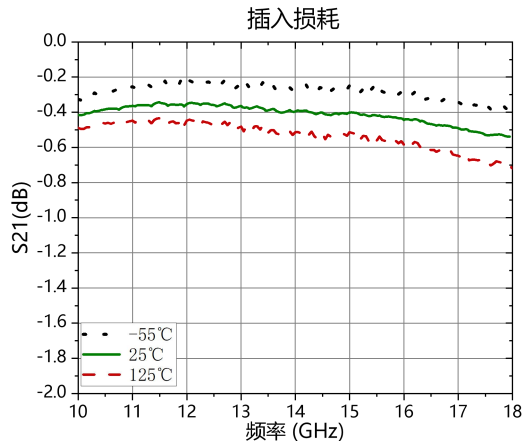
指标	数值	备注
最大输入功率	19.5W@12GHz	(pulsed.PW=2ms.DC=20%), +25℃
烧结温度	290℃	-
存储温度	-55~150℃	-
工作温度	-55~125℃	-

注：超过最大值都有可能造成永久性损坏

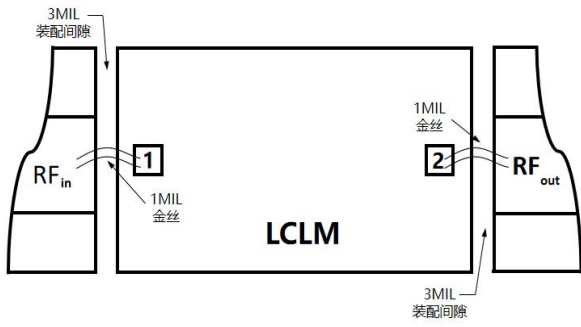
电性能表 (TA=+25℃)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	-	0.39	-	dB
回波损耗	-	22	28	dB
限幅电平	-	16.5(10GHz)	-	dBm
	-	16(11GHz)	-	dBm
	-	16.5(12GHz)	-	dBm
	-	16.5(13GHz)	-	dBm
	-	17(14GHz)	-	dBm
	-	15(15GHz)	-	dBm
	-	14(16GHz)	-	dBm
	-	14.5(17GHz)	-	dBm
	-	15(18GHz)	-	dBm
最大输入功率	-	19.5(pulsed.PW=2ms.DC=20%) @12GHz	-	W

典型测试曲线



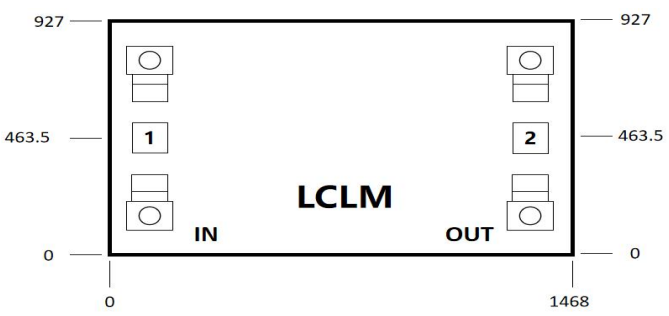
装配示意图



说明:

- 1. 单位: 微米 (um), 尺寸公差: ±50um
- 2. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100um x 100um
- 3. 芯片背面镀金
- 4. 芯片背面接地
- 5. 不可在通孔上进行键合
- 6. 压点间隙: 150um (GSG)

芯片尺寸图



键合压点定义

压点 编号	功能 符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端, 阻抗 50Ω (建议外接隔直电容)
2	RFout	RF 输出端, 阻抗 50Ω (建议外接隔直电容)
-	GND	芯片背面必须接地